



大同特殊鋼株式会社
成長市場製品事業説明会
質疑応答（要旨）

開催日 2026年6月12日（金）
出席者 取締役常務執行役員 岩田 龍司
執行役員経営企画部長 斎藤 賢一郎

- Q. 半導体製造装置向けステンレス鋼について、グローバルシェアを50%にしていきたいとのことだが競合についてどのように見ているか教えてほしい。
- A. 欧米メーカーが能力増強を計画しており一部今年度に稼働開始するという情報を得ているので、競合関係については楽観視していない。当社は既に能力増強を図ってきたので需要が増えたときの上方弾力性は十分確保できている。足元の非常に高い引き合いに対しては対応できている。
- Q. 機能材料・磁性材料セグメントの営業利益について、2021-2022年度の半導体のピーク時は250億円レベルであった。2026年度以降半導体製造装置向けステンレス鋼の数量が増えれば利益もこのレベルまで回復すると考えてよいか教えてほしい。
- A. 2021-2022年度については、自動車向け、産業機械向けステンレス鋼の数量も多かったので半導体製造装置向けステンレス鋼のみでこのセグメントの営業利益を説明するのは難しい。足元の需要環境がさらに上振れてくると200億円を超える営業利益は視野に入ってくると考えている。今後の見通しのなかで具体的な数値をお示ししていきたい。
- Q. 磁石事業について、既存工場への投資で2030年度に売上高500億円を目指すという説明があったが、需要がさらに増えて能力増強が必要になった場合、グリーンフィールドへの投資の可能性はあるのか？
- A. 既存工場の能力が一杯になれば、海外も含めた新たな拠点への投資も検討していきたいと考えている。顧客としっかり会話しながら需要動向、ニーズを見ていきたい。
- Q. 成長市場製品のROSが2030年にむけて高まっていくがどのような想定か教えてほしい。
- A. 航空・宇宙については現在大型投資を行っており完工後の売上増により利益は大きく伸びていくと考えている。医療用チタンについては新しいVARが1基稼働開始したが2基目の稼働開始が控えており、能力増強による売上増により利益は伸びていくと考えている。新しいマーケットにチャレンジしていくなかで、さまざまな改善を行うことによる技術の習熟度アップも利益率向上に寄与していくものと考えている。
- Q. 生産アロケーション戦略について、どれくらいの時間軸でシナジー効果が発現するのか教えてほしい。
- A. 現在、各社の営業部門、生産部門、企画部門が連携して計画を作成しているところである。2027年度以降

にシナジー効果を発現していきたい。早ければ 2026 年度下期から一部発現できると期待している。渋川工場の工具鋼生産を日本高周波鋼業に移管することによって、渋川工場の自由鍛造品の余力が創出され、航空・宇宙分野などの高合金生産をさらに拡大していくことの効果は大きくなると考えている。次期中期計画の重要な要素の一つだと考えているので具体的な数値についてはもう少しお時間をいただきたい。

- Q. クリーンスターよりも耐食性の良い商品を開発中とのことであるが、どの程度差別化された商品かについて教えてほしい。
- A. 現時点では詳細をお伝えできないが、2026 年度中にはリリース予定である。その際にはこの製品の特性面などできるだけわかりやすく紹介したい。
- Q. 半導体製造装置向けステンレス鋼の目標シェア 50%について、2025 年 1 月の半導体製造装置向け製品事業説明会からの変化点など進捗状況を教えてほしい。
- A. これまで取引のなかった米国の会社との取引開始については順調に進んでいる。一方で米国の鉄鋼関税の影響により想定していた受注拡大につながっていかないところもある。引き続きシェア 50%に向かって鋭意活動推進中である。受注拡大した際にきちんと生産対応できることが大事だと考えている。溶解、鑄込、圧延および二次加工まで含めて一貫生産できるメーカーは限られている。当社は知多第 2 工場の立上げと相まってすべての能力が整っている状態にある。
- Q. 半導体関連の受注をどのように見ているか。資料 9 ページのグラフには自由鍛造品の半導体関連が入っているか教えてほしい。
- A. グラフは鋼材の指標であり自由鍛造品は入っていない。半導体製造装置向けステンレス鋼の受注は 3 月以降急速に積み上がってきている。これが安定した受注かどうかについてしっかり見極めていきたい。長期目線では右肩上がりになると想定している。
- Q. 資料 11 ページの「航空・宇宙向け売上推移」グラフについて、宇宙向けはどの区分に入っているか教えてほしい。
- A. 宇宙向けは「高合金バー」「その他」に入っている。割合としては「その他」に多く含まれており、「高合金バー」には一部含まれていると見ていただきたい。
- Q. 半導体は今後もシクリカルな調整の動きがあり需要の急減が起きることも想定されるが、リスク耐性について教えてほしい。
- A. 需要の急減の影響を単一の製品でカバーするのは難しい。成長市場製品に期待しながら製品群を徐々に広げていっている。設備の共用ができていますので、半導体製造装置向けステンレス鋼の数量が減っても、溶解設備であれば自由鍛造品の高合金が代替製品として活用できる。二次加工であれば圧延棒鋼の高合金やチタンが代替製品として活用できる。これらで補えないところについてはライン別に稼働率の調整を行うなどの運営を行っていく。今後もある程度需要増減があることを前提にさまざまな対策は考えていきたい。
- Q. 2025 年 1 月の半導体製造装置向け製品事業説明会で、今後の技術動向の変化として Gate-All-Around や 3D NAND になると大同の受注が増えるというような説明があったが、今回の資料にはそれは織り込まれているか、上振れ要素になるかどうか教えてほしい。

A. 本日の資料には織り込んでいない。このような技術の進歩によって、当社の受注は拡大していくと考えているので、今後、その動向についてもお示しできるようにしていきたい。

本資料に記述されております業績見通し等の数値につきましては、現状で判断しうる一定の前提に基づいております。

今後発生する状況の変化によっては異なる業績結果となることも予想されますので、投資等の判断材料として全面的に依拠されることは差し控えていただきますようお願いいたします。

また今後予告なしに予想数字が変更されることがあります。本資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、各自の判断と責任において使用されるものであり、本資料にある情報の使用による結果について、弊社は何らの責任を負うものではありませんのでご了承ください。